

Z590, le top di gamma ASUS e GIGABYTE



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/schede-madri/9282/z590-le-top-di-gamma-asus-e-gigabyte.htm>)

Le nuove schede dovrebbero arrivare a fine mese, ma i processori Rocket Lake potrebbero arrivare molto dopo.






Intel ha tolto i veli alla nuova piattaforma desktop basata su CPU Rocket Lake e schede madri equipaggiate con chipset Z590 e B560, che porta con sé diverse interessanti novità .

Gli Intel Core di 11a generazione saranno gli ultimi ad essere realizzati con processo produttivo a 14nm e

saranno compatibili anche con le schede madri della serie 400 così come i Comet Lake, viceversa, saranno compatibili con la serie 500 dato, ovviamente, l'utilizzo comune del socket LGA 1200.

11th Gen Intel® Core™ Desktop Processor Architecture

New Core Architecture	New Enhanced Graphics	New AI Integration
 up to 19% IPC improvement	 up to 50% better integrated graphics performance	 Intel® Deep Learning Boost

All-new platform powering the next generation of desktops

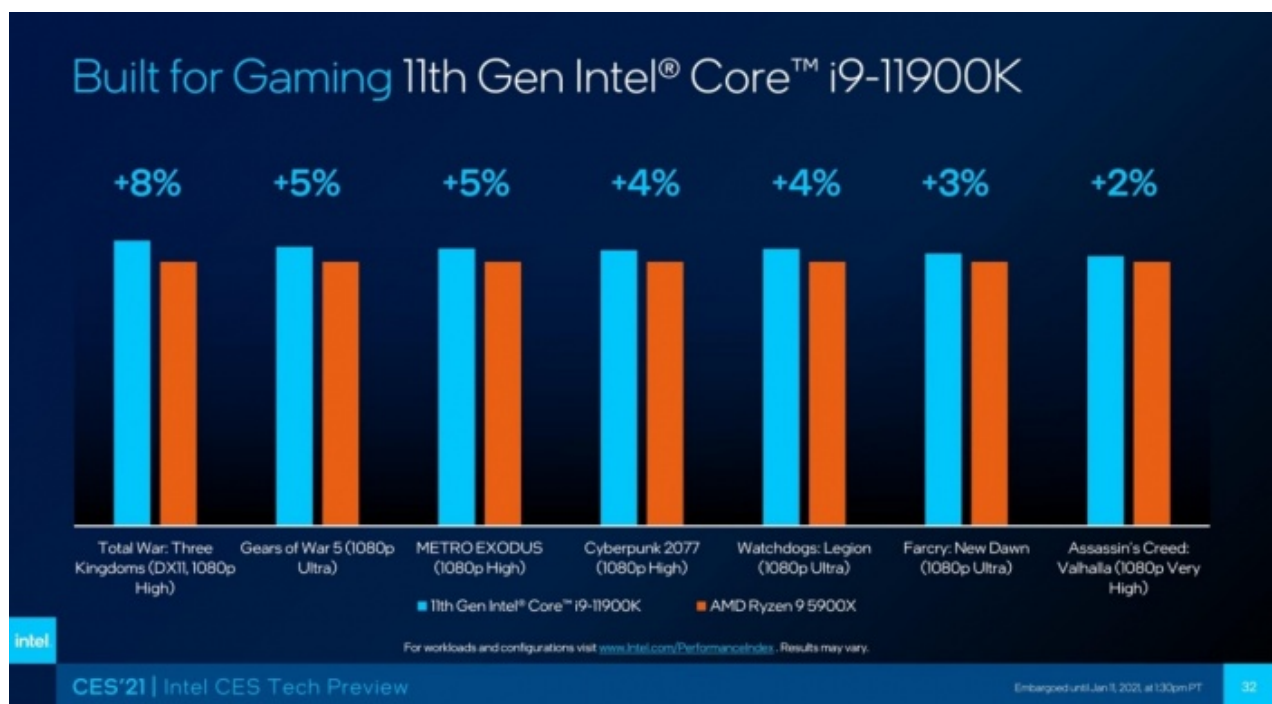
For workloads and configurations visit www.intel.com/PerformanceIndex. Results may vary.

CES'21 | Intel CES Tech Preview Embargoed until Jan 15, 2021, at 130pm PT 30



La nuova architettura Cypress Cove (un ibrido tra il design di Sunny Cove e Willow Cove) offrirà un miglioramento dell'IPC in doppia cifra rispetto a Skylake (19%), il supporto nativo alle DDR4 3200MHz, grafica integrata Intel Iris Xe, USB 3.2 Gen 2x2 da 20 Gbps, Thunderbolt 4 (compatibile USB4), Wi-Fi 6 e, finalmente, 20 linee PCI-E 4.0 che si andranno ad aggiungere a quelle rese disponibili dai PCH Z590 e B560, quest'ultimo sbloccato per quanto concerne l'overclock delle memorie.

L'offerta sarà declinata su tre linee di CPU, ovvero Core i9, Core i7 e Core i5, con il modello di punta, Core i9 11900K che, contrariamente alle attese, si fermerà a soli 8 core con HT e frequenza massima su un singolo core di 5,3GHz per un TDP di 125W.



Intel ha rilasciato i primi dati circa le prestazioni in gaming, dato che è solo questo l'ambito in cui al momento se la può giocare con AMD, che sembrano leggermente superiori a quanto ottenibile utilizzando

un Ryzen 9 5900X.

Passando, ora, alle schede madri che hanno cominciato a fare capolino sul mercato, quelle che ci hanno maggiormente colpito, ancora una volta, sono le proposte di fascia alta di ASUS e GIGABYTE, la prima con le sue ROG MAXIMUS XIII EXTREME, EXTREME GLACIAL e HERO, la seconda con le sue Z590 AORUS XTREME e MASTER.





Particolare cura è stata posta anche per tenere a bada i bollenti spiriti degli SSD PCIe Gen 4 di ultima generazione che, a fronte di prestazioni da primato, sembrano scaldare parecchio, con i relativi slot dissipati su tre lati.



Non da meno GIGABYTE, che sulle sue AORUS di punta ha previsto un design VRM a 20+1 fasi da 100A

l'una per un esorbitante totale di 2100A complessivi, il tutto raffreddato da due grandi dissipatori con alette in alluminio (Fins Array II) ed interconnessi tramite una robusta heatpipe in rame nichelato (Direct Touch II).



Le nuove schede Z590 di AORUS utilizzano la tecnologia proprietaria "XTREME MEMORY" che include piste completamente schermate, saldature dei punti di ancoraggio degli slot DIMM su entrambe le facciate del PCB tramite tecnologia SMT Memory DIMM e array di condensatori polimerici al tantalio per ridurre al minimo tutti i disturbi e le interferenze elettriche.